

●SOT-23(TO-236)パッケージ許容損失(JESD51-7)

SOT-23(TO-236)パッケージにおける許容損失特性例となります。

許容損失は実装条件等に影響を受け値が変化するため、下記実装条件にての参考データとなります。

1. 測定条件(参考データ)

測定条件：基板実装状態

雰囲気：自然対流

実装：Pb フリーはんだ

実装基盤：4層基板 76.2mm×114.3mm

(片面約 8700mm²) に対して

1層目：銅箔無し放熱板と周りの銅箔接続

2層目：70mm×70mm_放熱板と接続有

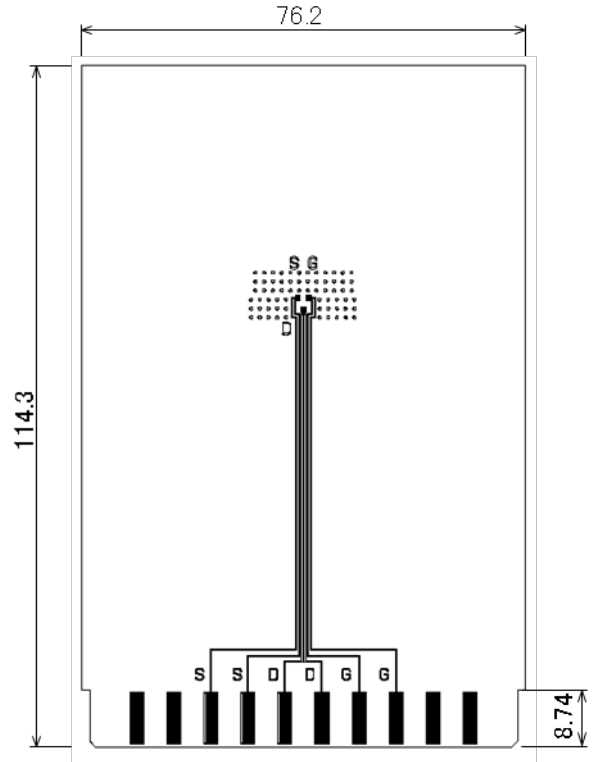
3層目：70mm×70mm_放熱板と接続有

4層目：銅箔無し

基板材質：ガラスエポキシ (FR-4)

板厚：1.6mm

スルーホール：φ0.2mm 60個



評価基板レイアウト(単位:mm)

2. 許容損失-周囲温度特性

基板実装(T_{jmax}=150°C)

周囲温度(°C)	許容損失 Pd (mW)	熱抵抗(°C/W)
25	400	312.50
85	208	
150	0	

